

DH-7018 技术说明书

一.用途

DH-7018 改性硅烷胶是专为电子、电器等产品特殊要求研制的，单一组份，室温固化胶。

1.2 适用于电子元器件，机壳结构件的粘接定位及加固，防水密封。

1.3 可用于粘接 PC,ABS,PBT,PVC,金属，橡胶，玻璃等大多数材料。

1.4 适用于户外复杂恶劣环境工业电子产品密封和防水保护。

1.5 适用于潜水产品，长期浸泡在水下的设备和产品的深度防水。

二.产品特性

符合 RoHS、HF、REACH 等环保要求。

绝缘性优秀、粘接性好，防潮、抗震、耐电晕、抗漏电、耐酸碱等

耐温广泛（-50℃~250℃），绝缘强度高。

不含溶剂,挥发物为醇类，环保，耐老化，耐化学品。

三.技术参数

项目	结果
外观	白色、黑色

DH-7018 技术说明书

粘度 Mpa.s	30000-50000
25℃比重（g/ml）	1.4±0.1
邵氏硬度(HA)	35-45
25℃表干时间(min)	5~30
25℃初步固化 24(H)	≥3mm
剪切强度（MPa）	>2.0
体积电阻率：（Ω·cm）	≥10 ¹⁴
电气强度（KV/mm）	≥18
耐温范围（℃）	-50~250

拉拔力粘接强度测试

粘接材料	粘接面积	单位	测试结果
PC+PC	5MM*25MM	N	205
PC+铝	5MM*25MM	N	187
铝+铝	5MM*25MM	N	180

注：以上产品固化后数据均为温度 25℃，相对湿度 50±5%条件下，固化 7 天后测试所得。

DH-7018 技术说明书

四.使用方法

- 1.基材清洁：祛除油污、灰尘、锈迹等，使施胶表面清洁干燥。
- 2.施胶：可手动或使用点胶设备，将胶涂布到相应基材的施胶部位即可。
- 3.固化：本产品是湿气固化材料，其表干及固化速度取决于材料使用环境的相对湿度、温度以及施胶的厚度（2-5mm），一般在 25℃,RH：50~60%的条件下固化 72 小时即可形成以上测试粘接强度数据，24H 后可以做气密性测试，固化七天后，方可做耐酸，耐碱，防水，浸泡，高低温等耐候性测试，本产品施胶厚度不宜超过 10MM。
- 4.注意事项：开封后未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存，再次使用时，若封口处有少许结皮，去除后即可使用，不影响胶体的性能。

五·包装、储运及保质期

- 1.包装：50ML/支，100ml/支；300ml/支（25 支/箱）；或按客户要求。
- 2.储运：本品为无毒非危险品，按一般化学品搬运，储存于阴凉（室温）干燥处。
- 3.保质期：6 个月（室内 23℃ 以下）。

说明：以上数据是依据我们广泛实验所得，结果是可靠的。但由于实际应用的多样性，应用条件不是我们所能控制，所以用户在使用前需进行试验以确认本品是否适用。我公司不担保

DH-7018 技术说明书

特定条件下使用我公司产品出现的问题,不承担任何直接、间接或意外损失的责任。用户在使用过程中遇到什么问题,可以和公司技术服务部联系,我们将竭力为您提供尽可能的帮助。

競合新材料